



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091117002
2010 年 12 月 14 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP nFBGA パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内

(初版 PCN20091117002 2009 年 11 月 20 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	ASP nFBGA パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2011年1月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルは11月下旬の出荷より実施しています。)			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容:弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) nFBGAパッケージ 一部製品について、
 現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、ボンディングワイアの機械/電気
 的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、これに替えて、Cu(銅)線 ボンディング
 ワイアへ移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特
 性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線

理由: 機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名

対象製品名				
C6421SURFVOZWT4	DM355SZCEA216	M355ZCE270QUADRANT	M6444ZWTTIME	TMS320C6424ZWT7
C6421SURFVOZWT4B	DM355ZCE216DTEG	M355ZCE270WPGSF	M6446AZWTBESTA	TMS320C6424ZWTL
C6421SURFVOZWT5	DM355ZCE216ECH	M6435CZWTSLG	M6446AZWTBJSF	TMS320DH6435ZWT6
C6421SURFVOZWT5B	DM6437ZWT6-IOIMAGE	M6441AZWTBJSF	M6446AZWTHAIER	TMS320DH6443ZWT
C6421SURFVOZWT6	DM6441ZWTARCH	M6441AZWTHAIERIN	M6446AZWTHAIERIN	TMS320DH6446ZWT
C6421SURFVOZWT6B	DM6441ZWTARCL	M6441AZWHTSPHI	M6446AZWTHISENSE	TMS320DM335CZCE135
C6424SURFVDZWT4	DM6441ZWTBEK	M6441AZWTIFLYTECH	M6446AZWTPAV	TMS320DM335CZCE216
C6424SURFVDZWT4B	DM6441ZWTMSN	M6441AZWTMIGRO	M6446AZWTPM	TMS320DM335CZCE270
C6424SURFVDZWT5	DM6443ADB6C3126MP	M6441AZWTPM	M6446AZWTSKYWORTH	TMS320DM335ZCE135
C6424SURFVDZWT5B	DM6443DB6C3125MP	M6441AZWTSEED	M6446AZWTTONGLI	TMS320DM335ZCE216
C6424SURFVDZWT6	DM6446AAB6C4130VD	M6441PMPZWTING	M6446ZWTAVMEAWOX	TMS320DM335ZCE270
C6424SURFVDZWT6B	DM6446ANB6C2127VC	M6441PNDZWTING	M6446ZWTAVMEHIMEDI	TMS320DM335ZCEA135
C6424SURFVOZWT4	DM6446APB6C6128ED	M6441PTVZWTING	M6446ZWTAVMEMOTO	TMS320DM335ZCEA216
C6424SURFVOZWT4B	DM6446AZWTKEDACOM	M6441ZWTHAIERIN	M6446ZWTHAIERIN	TMS320DM350HAZWK
C6424SURFVOZWT5	DM6446EB6C2110VS	M6441ZWTSREU	M6446ZWTHAIFERSF	TMS320DM350HZWK
C6424SURFVOZWT5B	DM6446GB6C0121MV	M6443AZWTBJSF	M6446ZWTHISENSE	TMS320DM350HZWKR
C6424SURFVOZWT6	DM6446HB6C0114VC	M6443AZWTHAIER	M6446ZWTJIUZHOU	TMS320DM350LAZWK
C6424SURFVOZWT6B	DM6446IB6C0107VS	M6443AZWTKAITIAN	M6446ZWTRINCOTEX	TMS320DM350LZWK
DM335SZCE135	DM6446IB6C4112VS	M6443AZWTPM	M6446ZWTSKYWOTH	TMS320DM350ULZWK
DM335SZCE216	DM6446LB6C3108VS	M6443ZWTARTIES	M6446ZWTSREU	TMS320DM355CZCE135
DM335SZCE270	DM6446LB6C3109VS	M6443ZWTAMI	M6446ZWTSTYLE	TMS320DM355CZCE216
DM335ZCE135TYCO	DM6446MICD1C2104SC	M6443ZWTAVMEAWOX	M6446ZWTSYS	TMS320DM355CZCE270
DM350HZWK-ACM	DM6446MLTD1C2105ST	M6443ZWTAVMEHIMEDI	M6446ZWTVERISMO	TMS320DM355CZCE27J
DM350HZWK-KD17	DM6446NB6C5123NP	M6443ZWTAVMEKONKA	M6446ZWTVTAILYN	TMS320DM355CZCEA13
DM350HZWK-KD53	DM6446RB6C6122VP	M6443ZWTAVMEMEDIAE	M6447ZWTAVMEMOTO	TMS320DM355CZCEA21
DM350HZWKMINTON	DM6446RB6C6124VP	M6443ZWTAVMEYUXING	M6447ZWTAWX	TMS320DM355ZCE135
DM350LZWKAB	DM6446SB6C6117MD	M6443ZWTAVMEZTE	M6447ZWTLEADTEK	TMS320DM355ZCE216
DM350LZWK-ACM	DM6446ZB6C3111VP	M6443ZWTING	M6447ZWTTIME	TMS320DM355ZCE270
DM350LZWKAO	DM644NECED1C2102VC	M6443ZWTJET	SN3490586	TMS320DM355ZCEA135
DM350LZWKMINTON	F761516ZAV	M6443ZWTVERISMO	TMS320C6421ZWT4	TMS320DM355ZCEA216
DM350LZWKPHIL	M350ZWKDPFING	M6443ZWTVTAILYN	TMS320C6421ZWT5	TMS320DM357ZWT
DM350UHZWKHD	M355ZCE216BSTSP	M6443ZWTWNC	TMS320C6421ZWT6	TMS320DM6431ZWT3
DM350ULZWKMINTON	M355ZCE216CCTV	M64444ZWTAVM	TMS320C6421ZWT7	TMS320MED355ZCE216
DM355SZCE135	M355ZCE216JABIL	M6444AZWTAIRTIES	TMS320C6421ZWTL	
DM355SZCE216	M355ZCE216NEXTAR	M6444AZWTAMI	TMS320C6424ZWT4	
DM355SZCE270	M355ZCE216WPGSF	M6444ZWTAMI	TMS320C6424ZWT5	
DM355SZCEA135	M355ZCE270BSTSP	M6444ZWTAVM	TMS320C6424ZWT6	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009年11月15日	終了	2010年8月29日
---------	----	-------------	----	------------

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	X6567G4NN0ZWKR	Die Size (mm2):	99.47, 28.83
Wafer Fab:	DMOS6 / SMIC, UMC12A / DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.26NOW, 1218C027.05NOW
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZWK/385
Die Attach:	84-3MV	Mold Compound:	KMC 3580T
Bond Wire:	0.8 mils Dia., Cu	Solder Ball Composition:	SnAgCu
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		Lot #1	Lot #2	Lot #3	Lot #4	Lot #5
**THB	85C/85%RH, 600HRS	13/0	13/0	13/0	13/0	13/0
**UHASt	110C/85%RH, 264HRS	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0
**Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0
**Storage Bake	150C, 600HRS	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0

Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009年11月15日	終了	2010年8月29日
---------	----	-------------	----	------------

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	F761516ZAV	-	-
Wafer Fab:	DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.05
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZAV/289
Die Attach:	Hitachi 84-3MV	Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580LTVA
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	501/0	506/0	503/0

Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009年11月15日	終了	2010年8月29日
---------	----	-------------	----	------------

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	F761541AZVLR	-	-
Wafer Fab:	DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.06
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZVL/354
Die Attach:	Hitachi 84-3MV	Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580T
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails					
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	Lot#4	Lot#5	Lot#6
**THB	85C/85%RH, 1000HRS	40/0	29/0	42/0	40/0	39/0	39/0
**UHASt	110C/85%RH, 264HRS	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
**Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
**Storage Bake	150C, 1000HRS	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
Manufacturability	-	Approved					

Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C